

（一社）日本半導体製造装置協会における 自主行動計画フォローアップ調査について

令和4年3月3日

（一社）日本半導体製造装置協会

1. これまでの取組（周知・啓蒙等）

令和3年度に自主行動計画を改定し、下記の周知・啓蒙を行った

- 令和2年の課題と対応方針を盛り込んだ自主行動計画の改定を実施（令和3年9月17日）
 - ・ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備
 - ・ 手形などの支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
 - ・ 5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する（令和3年度の成長戦略実行計画）
 - ・ 知的財産の取り扱い
- 改定版の会員へ周知
 - ・ ホームページおよびメールにて会員へ周知

2. 令和3年度フォローアップ調査結果（概要）

- 調査期間：令和3年10月13日～10月25日
- 調査企業：日本半導体製造装置協会の会員企業34社を対象
- 回答企業：15社（昨年度21社）
- 回答率：44%（昨年度61%）

（反省点）

改定からFUまで短期間となり会員が混乱して回答率が下がった
令和4年度は、スケジュールを見直して回答率を改善したい

2. 令和2年度フォローアップ調査結果（概要）

概観（改善できた点、改善の余地がある点等特筆すべき内容）

- ① 原価低減要請の適正化は、ほぼ全社実施済 <良好継続>
- ② 単価決定への協議は発注・受注とも全社実施済 <良好継続>
- ③ 型管理はルール・マニュアル化の未実施が約1割 <継続課題>
- ④ 狭義・広義「手形払い」において「全て現金」は約5割
- ⑤ 狭義 手形サイトは120日以内に偏る <継続課題>
- ⑥ 広義「約束手形の利用廃止」は「予定なし、未定」を合わせて約4割。 <新規課題>
- ⑦ 働き方改革に伴う影響は全社無し <良好継続>
- ⑧ 知的財産権の適正取引に向けた契約および発注は全社実施

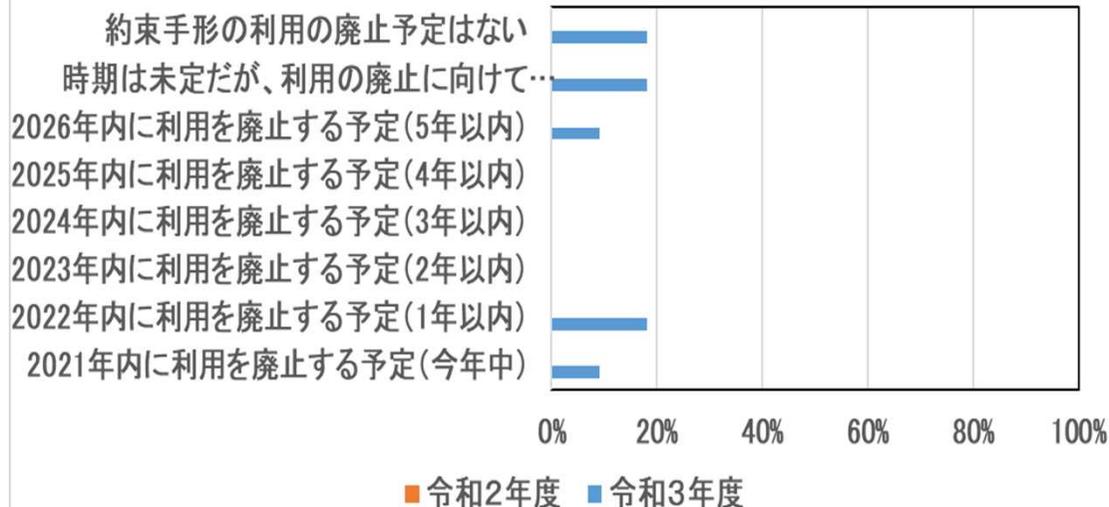
3. 令和元年度フォローアップ調査結果と分析

重要改善指標 ④-3 広義 下請支払い方法

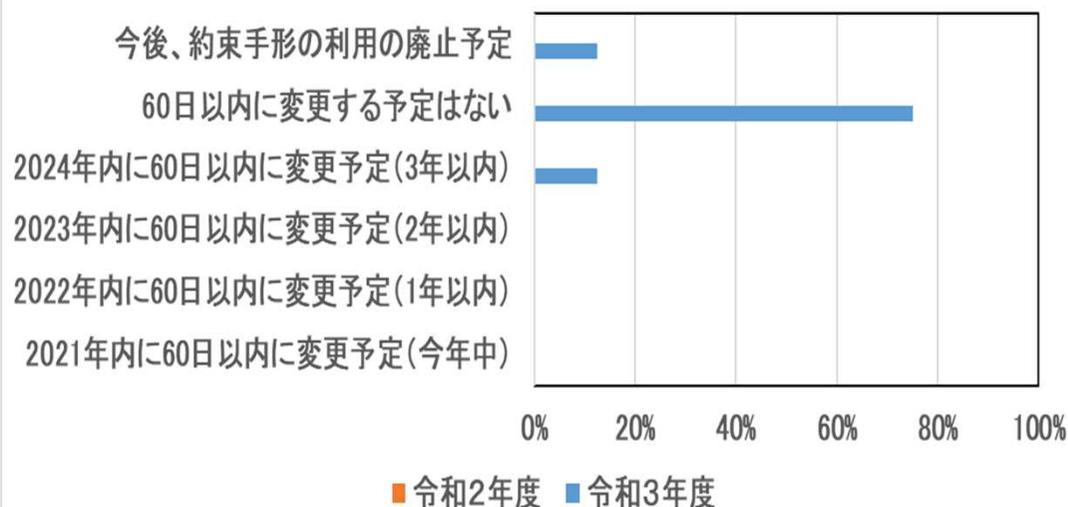
【設問29/32】 手形の廃止の予定、サイトを60日以内にする予定

- 約束手形の廃止予定がないが約2割であり、〈新規課題〉とする
- 手形サイト60日以内への変更予定がないが約8割であり、〈新規課題〉とする

設問29 下請代金(発注側)(広義)
廃止予定



設問32 下請代金(発注側)(広義)
手形サイト60日以内の予定



3. 令和元年度フォローアップ調査結果と分析

重要改善指標④-6 手形支払いのまとめ

<課題>

- 支払いは、「現金支払い」および「手形支払い50%以上」に偏る
- 手形サイトが、120日以内と120日超（大企業間）に偏る
- 手形支払いの廃止予定がないが約2割
- 手形サイトを60日以内にする予定がないが約8割

<今後の方針>

- 約束手形の廃止予定がない理由として、取引先からの要望が約4割、取引先が電子決済未対応が約2割であり、サプライチェーン全体での取り組みも必要

5. 今後の取組

【今後の取組】

- 会員企業同士の意見交換会による課題共有と適正取引の推進
（例：型管理、手形支払い、パートナーシップ構築宣言）
令和4年度中に少なくとも1回実施を予定する
- 特に手形廃止が困難な会員とは時間をかけて意見交換を行い、
廃止に向けた準備を促す。
- パートナーシップ構築宣言について取組状況を把握し（FUで
は未確認）、宣言に向けて推進する
- 調査や意見交換会の結果を反映して自主行動計画を令和4年度
中に改定する